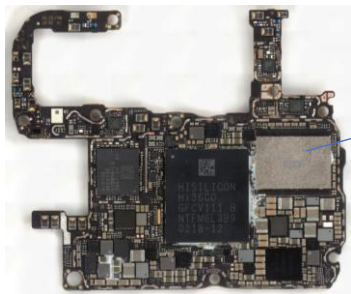


3D NAND フラッシュメモリ：YMTC (HUAWEI Pura X搭載) 構造解析レポート



HUAWEI Pura X搭載基板



3D NAND パッケージ

レポート背景と概要

YMTC（長江存儲科技）は、中国政府の強力な支援を受ける中国最大の3D NANDフラッシュメーカーです。独自の積層技術「Xtacking」を武器に驚異的なスピードでシェアを拡大し、世界市場で、Samsung、SK hynix、キオクシアに次ぐ第4位に躍進しています。

YMTCの3D NANDフラッシュメモリは、Huawei、Xiaomi、VivoやOPPOなど、中国ブランドの端末において多く採用が進んでいます。

今回、2025年3月に発売されたHUAWEI Pura X搭載のYMTC社 3D NANDフラッシュメモリの構造解析レポートをリリースします。

製品特徴

HUAWEI Pura X搭載 3D NAND フラッシュメモリ 製品リリース日(Pura X)：2025年3月

Xtackingアーキテクチャ採用

YMTC独自の周辺回路（CMOS）とメモリセルを別々のウェハで製造し、ハイブリッドボンディング技術で接合。

解析内容 & レポート価格

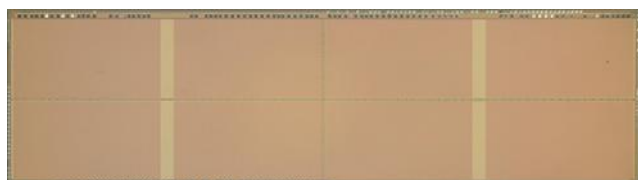
構造解析レポート 価格：¥800,000 (税別) 発注後1weekで納品

- ・1PKG内にフラッシュメモリチップは、4チップ搭載(2チップ積層×2)され、インターフェースICチップも搭載されている。
- ・メモリセル部断面解析(WL, BL方向)を行い、構造確認とXtackingの世代、メモリゲート積層数の確認、配線ピッチからのプロセス推定を行っています。
- ・平面解析では、メモリセル、チップ裏面側からの観察を行っています。

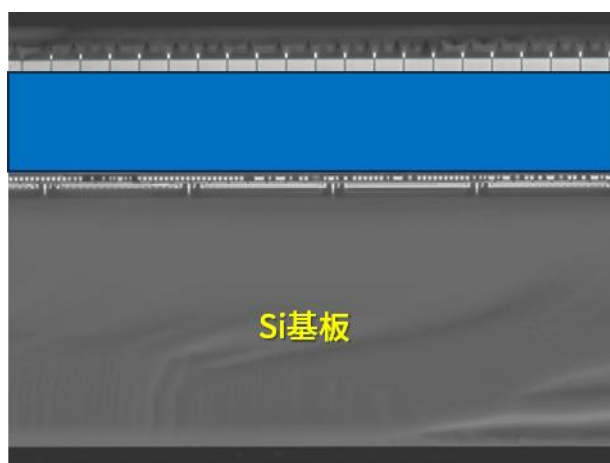
構造解析レポート目次

	Page
1. デバイスサマリー	3
2. 製品分解	4
3. パッケージ観察	5
4. X線観察	6
5. チップ観察	8
6. 断面構造解析	11
7. チップ裏面観察	32
8. 平面SEM観察	39
9. 解析まとめ	41

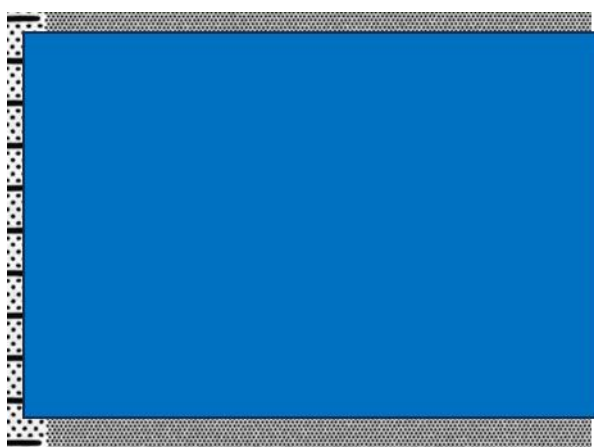
構造解析レポートからの抜粋



3D NANDチップ写真



メモリセルの断面SEM像



メモリセルの平面SEM像